

中信建投证券股份有限公司

关于

**宸芯科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市**

之

上市保荐书

保荐人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二六年五月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人潘可、李志强已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义.....	3
一、发行人基本情况	5
二、发行人本次发行情况	16
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式	17
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明	21
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项	21
六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明	22
七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程	23
八、保荐人关于发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明	24
九、持续督导期间的工作安排	28
十、保荐人认为应当说明的其他事项	29
十一、保荐人关于本项目的推荐结论	29

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

一、常用词汇释义

宸芯科技、公司、本公司、发行人	指	宸芯科技股份有限公司
宸芯有限	指	宸芯科技有限公司，系公司股份制改造前的公司名称
本次发行	指	本次拟向社会公众公开发行不超过 403,029,995 股 A 股股票的行为
中国信科	指	中国信息通信科技集团有限公司，系公司控股股东
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人
《公司章程》	指	现行有效的《宸芯科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《首次公开发行股票注册管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》
A 股	指	中国境内发行、获准在证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所、证券交易所	指	深圳证券交易所
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中信建投证券、保荐人	指	中信建投证券股份有限公司
致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、最近三年	指	2023 年度、2024 年度、2025 年度
报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日
报告期末	指	2025 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业词汇释义

SDR	指	Software Defined Radio，软件定义无线电，是一种无线电通信系统构建技术
SoC	指	System on Chip，芯片级系统，也称片上系统，是一个有专用目标的集成电路，包含了具有特定功能的完整的系统，并具有嵌入软件的功能
C-V2X	指	Cellular Vehicle to Everything，蜂窝车联网，是一种以蜂窝技术为基础的车联网无线通信技术
IP	指	Intellectual Property，已验证的、可重复利用的、具有某种特定

		功能的集成电路模块
2G、3G、4G、5G、6G	指	第二代、第三代、第四代和第五代和第六代移动通信技术与标准
5G NR	指	基于正交频分复用技术的全新空口设计的全球性 5G 标准，属于第五代移动通信技术
空天地海一体融合通信/空天地海全域通信	指	深度融合天基（卫星）、空基（高空平台）、地基（地面蜂窝网络等）、海基（水面及水下通信节点）四大维度网络资源，构建的面向全域无缝覆盖的立体化信息通信网络，是第六代移动通信技术（6G）网络的典型特征
GNSS	指	Global Navigation Satellite System，全球导航卫星系统
HARQ	指	Hybrid Automatic Repeat reQuest，混合自动重传请求，是一种将前向纠错编码（FEC）和自动重传请求（ARQ）相结合而形成的技术
B-TrunC	指	Broadband Trunking Communication，宽带集群通信，是由宽带集群产业联盟组织制定的基于 TD-LTE 的“LTE 数字传输+集群语音通信”专网宽带集群系统标准
GSM-R	指	GSM for Railways，专门为铁路通信设计的数字移动通信系统，一种轨交通信技术
NTN	指	Non Terrestrial Network，非地面网络
功率	指	一种物理量，反映电子元器件单位时间内能量输出的效率，计算上等于流经元器件的电流与元器件两端电压的乘积
多模多待	指	支持多种网络模式，多张卡待机
通信制式、通信体制	指	用来定义某一种通信体系的具体参数、功能、样式的标准
通信波形、波形	指	某类通信制式的一种具体实现

特别说明：本上市保荐书中，部分合计数与各分项数直接相加之和存在尾数差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入造成。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：	宸芯科技股份有限公司
英文名称：	Morningcore Holding Co., Ltd.
注册资本：	196,773.4686 万元
有限公司成立日期：	2019 年 12 月 20 日
股份公司设立日期：	2022 年 11 月 24 日
法定代表人：	吕东风
董事会秘书：	孙业亮
住所：	山东省青岛市黄岛区珠江路 1699 号 16 栋 102 户
主营业务：	公司专注于无线通信 SoC 芯片及模组类产品的研发、设计及销售，是国家级专精特新重点“小巨人”企业，始终致力于为客户提供自主、安全、可靠的无线通信芯片及解决方案。报告期内，公司主营业务涵盖基带通信类、数模混合类芯片及模组产品，以及芯片定制服务、技术服务等，产品与解决方案广泛应用于低空经济、商业航天、专用无线通信以及车联网等领域
电话号码：	021-31271010
互联网网址：	https://www.morningcore.com
本次证券发行的类型：	首次公开发行股票并在创业板上市

（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

1、主营业务概况

公司专注于无线通信 SoC 芯片及模组类产品的研发、设计及销售，是国家级专精特新重点“小巨人”企业，始终致力于为客户提供自主、安全、可靠的无线通信芯片及解决方案。报告期内，公司主营业务涵盖基带通信类、数模混合类芯片及模组产品，以及芯片定制服务、技术服务等，产品与解决方案广泛应用于低空经济、商业航天、专用无线通信以及车联网等领域。在商业航天领域，公司系国家卫星互联网工程宽带终端基带芯片的承研单位和重要供应商，卫星互联网宽带终端基带通信芯片及模组类产品的国内市场占有率处于领先地位，最近三年相关领域收入的复合增长率为 98.71%，保持高速增长趋势；在低空经济领域，公司拥有无线图传芯片及完整通信解决方案，主要应用于民用无人机市场，在该市场的占有率位居国内前三，最近三年相关领域收入的复合增长率为 35.05%，维持较高的增长水平。

公司是中国信科旗下专业从事无线通信芯片设计及相关业务的唯一平台，系

全球范围内少数同时掌握 2G/3G/4G/5G、NTN、宽带自组网、C-V2X 等十余种通信制式及面向 6G、卫星互联网、空天地海一体融合通信等相关未来通信技术演进的无线通信芯片及解决方案提供商。公司在无线通信领域拥有深厚的技术积累，已形成超大规模 SoC 芯片设计技术、无线移动通信技术、软件定义无线电（SDR）芯片平台技术等三大核心技术群。其中，软件定义无线电（SDR）芯片平台技术经评审被认定为国际先进、国内领先水平。基于以上三大核心技术群，公司打造了具有高度灵活性的产品体系，通过软件定义的方式，单颗芯片可支持不同通信制式间的动态加载和多模并发通信，从而在低空经济、商业航天、专用无线通信、车联网等多个应用场景中实现高效、灵活的规模化应用。公司致力于为客户提供领先的可重构 SDR SoC 芯片及解决方案，以打造自主、安全、可靠的国产芯片为己任，致力成为国内一流、国际知名的集成电路设计企业，助力行业创新升级，践行国家集成电路产业发展战略。

公司高度重视对产品及技术的研发投入，研发能力突出，并不断进行技术积累及研发创新，已形成了一系列核心技术成果。截至报告期末，公司拥有专利 172 项，其中发明专利 170 项；集成电路布图设计专有权 12 项。同时，公司也是中国集成电路设计创新联盟理事单位、中国半导体行业协会成员单位、中国汽车芯片产业创新战略联盟成员单位、应急救援装备产业技术创新战略联盟成员单位，曾先后参与多项行业标准的起草及修订工作，在业内享有较高的品牌知名度及行业影响力。凭借长期以来的研发积累，公司先后参与了 8 项国家各级技术攻关项目或重大科技专项课题，其中 5 项为独家或牵头承担单位，进一步彰显了公司的研发技术实力和行业地位。

2、核心技术情况

公司核心技术如下表所示：

技术 大类	序号	名称	技术 来源	技术先进性及具体表征	相关知识产权 保护措施	技术所处 阶段
超大规模 SoC 芯片 设计技术	1	超大规模 SoC 低功耗设计技术	自主 研发	公司从架构级设计到后端物理设计形成了特色的超大规模 SoC 低功耗设计技术，包括先进工艺的低功耗设计及优化技术、处理器智能功耗管理技术。在芯片的系统级设计阶段，公司采用电源缩放技术区分多个电压域，对每个电压域采用不同的供电电压，从而在保证性能的情况下降低部分功耗。此外，公司通过减少使用高耗能的 ALU（即算术逻辑单元）操作、针对不同工作模式设置不同的时钟频率、在面积许可的情况下优先考虑并行处理 DSP 等多种方式进一步降低功耗。同时，在处理器层面，公司应用的省电技术还包括自适应调频技术、自动调压技术、加速器自动掉电技术等	已通过 2 项发明专利进行保护	批量应用阶段
	2	超大规模 SoC 芯片自动化验证技术	自主 研发	在自动化验证领域，公司已经开发出超大规模 SoC 芯片先进工艺物理实现流程，包括大规模多层次化设计方法、低功耗设计物理实现流程、大规模分布式电压降分析技术及大规模自动化高迭代验证技术等方法	已通过 1 项集成电路布图设计专有权进行保护	批量应用阶段
	3	高速高密度多芯片硅基封装测试技术	自主 研发	高速高密度多芯片硅基封装测试技术的先进性主要包括：①结合电源仿真技术与芯片热仿真技术，实现热源精准定位。将应力仿真和热变化结合模拟，保障芯片在宽温条件下散热和应力表现良好；②将电源分类模型与信号完整性仿真结合，解决电源和信号间相互影响的问题，以提升仿真准确性；③芯片测试阶段，在三温测试的基础上开发适配的动态电压测试方式，有效地检出早期失效芯片，有助于缩短芯片测试时间和测试成本。④改善封装工艺，增加晶粒筛选工序，优化切割和对准工艺，提升芯片良率。同时结合系统应用，采用不同等级良品混合的组合方式，提升满足性能要求的组合晶粒的产出量	已通过 2 项发明专利进行保护	批量应用阶段
	4	数模混合芯片设计技术	自主 研发	①将多个开关电源和多个线性电源集成在一颗单芯片上。②开关电源支持单相、双相可配置，双相模式支持 5~6A 电流输出，高压输出时最高工作效率点超过 90%。③可自定义的上电时序与电压值，可以灵活适配不同供电需求，拓宽电源芯片应用范围。④利用噪声隔离技术，保证各路电源互不干扰。⑤设计过温保护、欠压锁定、过压保护、短路保护、过流保护、软启动等电路，保证电源芯片可靠工作。⑥自研数字和模拟输入输出端口，通过器件、芯片	已通过 14 项发明专利、1 项实用新型专利和 4 项集成电路布图设计进行	批量应用阶段

技术 大类	序号	名称	技术 来源	技术先进性及具体表征	相关知识产权 保护措施	技术所处 阶段
				系统和封装多维度提高芯片的静电释放能力。⑦为处理器供电的降压电路支持动态电压频率调整控制。⑧克服稳定性、散热、启动、负载快速响应等诸多困难，单片集成 1.2A 大电流线性电源。	保护	
	5	高安全高可靠车规芯片设计技术	自主研发	高安全高可靠车规级芯片设计技术采用独特的启动安全技术、过程安全技术、功能安全技术以及可靠性设计技术，可满足通信信息安全、应用安全、产品稳定和使用寿命长的需求，解决通信基带芯片的安全可靠性问题。①为防止非法用户在系统启动过程中非法访问内部资源以及盗取用户信息，采用安全启动方案技术，允许用户采用非对称的签名与验签技术进行启动。②芯片内部配置硬件加解密模块（HSM），提供数据的加解密功能，包括加解密与数字签名验签设计。③进行工艺评估与 IP 选型时，对其宽温的支撑能力以及 IO 的 ESD 能力进行评估，确保芯片设计时采用的工艺制程与 IP 已通过宽温验证。④使用 ECC 技术提高存储器可靠性。ECC 是一种先进的存储器数据检错机制，采用数据块（block）概念与复杂的演算方法来修正数据。因此不仅能检测多位比特错误，还能进行修正单一比特的错误。⑤采用低功耗设计技术提高芯片的能效比，在不同的应用场景下使基带芯片乃至整机处于功耗节省的运行状态，从而利于降低芯片内部的结温和电磁辐射，增强芯片工作的可靠性。⑥后端设计时充分考虑与可靠性相关的规则，包括不合理的版图布局、电压降（IR drop）、电迁移效应（EM）、静电放电效应（ESD）、闩锁效应（latch up）、天线效应（antenna）等	已通过 6 项发明专利进行保护	批量应用阶段
无线移动通信技术	1	宽带无线自组网通信技术	自主研发	①灵活可变的网络拓扑结构，适合不同应用场景对通信组网的需求。②高实时性的动态路由策略：宽带无线自组网应用场景多种多样，为支撑多种不同业务场景、组网规模、不同的动态拓扑变化以及各种不同的外部环境，设计了与之匹配的路由算法：a.可通过实时感知网络拓扑变化、网络传输质量变化、关键节点识别以及各节点的业务负载情况，提供周期性和实时事件通知两种路由更新策略，兼顾考虑路由更新信息的空口资源占用情况和更新的实时性，有效确保全网数据的传输稳定性、质量及总吞吐量。b.可基于不同的节点优先级、业务优先级、业务服务质量需求，在端到端之间提供多条路由路径，各节点基于业务感知能力，选择适配的路由路径进行传输，以匹配不同的业务服务质量需求。c.充分考虑不同的组网规模、网络拓扑结构以及可能的异构网络架构，采用按需路由和表路由融合以及静态路由、半静态路由	已通过 17 项发明专利、1 项外观专利和 5 项软件著作权进行保护	批量应用阶段

技术 大类	序号	名称	技术 来源	技术先进性及具体表征	相关知识产权 保护措施	技术所处 阶段
				和动态路由融合的路由算法，在有效降低空口资源占用率的情况下，确保路由实时性。③分级服务质量保障，通过实时动态优先级调整，结合无线通信能力，最大程度保证高优先级业务的传输，以满足不同层面业务并发的需求。④自愈性和抗毁性，保证移动节点可以动态整合成同一网络。⑤支持 200Mbps 速率、最远 300 公里通信距离、256 节点大规模组网及低于 10 毫秒的低时延		
	2	低时延高可靠 C-V2X 通信技术	自主 研发	①公司自主研发的 C-V2X 通信协议栈支持 3GPP R14/R15/R16 技术标准，并支持演进到 R17 版本。②3GPP R16 C-V2X 协议标准支持最大相对车速 500 千米/小时，通信时延可小于 10 毫秒，支持最大 12,000 字节数据包，收包率可达到 99.99%。③公司自主研发的无 GNSS 场景定时同步和定位技术，支持在 GNSS 信号丢失时持续为车辆提供高精度自适应的定时同步和定位辅助功能，实现了 C-V2X 业务的连续性和可靠性。④公司支持面向 V2P 应用场景的低功耗解决方案，功耗可控制在 100mW 以内	已通过 21 项发明专利和 3 项软件著作权进行保护	批量应用阶段
	3	超宽带非地面通信技术	自主 研发	公司的超宽带非地面通信技术吸收了传统地面移动通信和卫星通信的双重优势技术，在 5G NR 技术架构的基础上实现了空、天、地、海一体化融合通信的方案设计，该技术同时面向 6G 典型应用场景，具备以下技术先进性：①基于可变参数集的统一空口设计方案，可根据用户使用场景、业务类型等需求自适应匹配空口体制，实现多体制下的智能网络接入。②采用支持数兆兆比特/秒传输速率的基带与射频高速接口技术，可支持最大 400MHz 的信道带宽。③满足超宽带下的复杂处理能力要求，支持高达 1Gbps 的数据传输速率。④结合位置信息，通过采用不同参考信号进行时、频域测量得到准确的时偏和频偏估计值，能对抗更大范围的多普勒频移，获得更精确的时偏精度，支持的最大多普勒频移为 35ppm。采用针对不同场景的自适应动态补偿步长和多阈值比较补偿方案，可以实现更快更精准的时、频偏补偿。⑤信号处理上引入了多符号合并检测技术、上下行重复传输技术、可配置的 HARQ 使能和关闭技术，针对性适配非地面通信场景下低信噪比和高传播时延的特点，可显著提高信号检测成功率和数据传输的可靠性。⑥终端移动性管理实现方案中，支持基于 GNSS 辅助终端位置上报和 RRM（即无线资源管理）测量结果的联合判决机制，支持基于小区移动状态信息的条件切换机制，支持基于双协议栈的切换机制，可以避免不必要的切换或重选，减少空口信令	已通过 10 项发明专利进行保护	批量应用阶段

技术大类	序号	名称	技术来源	技术先进性及具体表征	相关知识产权保护措施	技术所处阶段
				交互开销，缩短切换时延		
	4	毫米波幅相时频补偿技术	自主研发	毫米波幅相时频补偿技术在时域与频域分别或同时对硬件电路的失真进行补偿，幅度补偿的精度可以较小的代价达到仪表级别。除常规的幅度补偿外，该技术还通过对相位的补偿改善了矢量信号通过硬件电路后信号质量失真的问题，可在不依赖复杂数字算法均衡的前提下，在大带宽实现信号质量改善，补偿部分可以方便地在多个位置实现；此技术可应用在移动通信尤其是毫米波等大带宽通信的场景	商业秘密保护	批量应用阶段
	5	多体制公网融合通信技术	自主研发	①公司拥有自主研发的 2G/3G/4G 公网多模多待通信协议栈，可基于公司自主研发的 SDR SoC 通信芯片和 SDR 软件平台提供公网多模多待通信解决方案；②公司自主研发了集群、轨交专网以及宽带无线自组网通信协议，比如 B-TrunC 集群通信和 GSM-R 铁路通信。针对集群通信和轨交通信的特点（支持广播、组播和单播通信），提供先进的实时性设计、优先级设计以及针对性的低功耗设计。③为满足不同行业的无线通信需求，特别是异构网络能力需求，基于公司自主研发的 SDR SoC 通信芯片以及 SDR 软件平台多波形管理技术，提供基于共享的硬件平台的多体制公网波形融合通信解决方案，可实时感知复杂的异构网络环境并及时选择合适的公网、专网、自组网波形进行实时的自适应切换、确保网络正常驻留和支撑业务连续性，以满足终端产品小型化、低功耗、业务实时连续性保证等多种需求	已通过 82 项发明专利和 7 项软件著作权进行保护	批量应用阶段
软件定义无线电（SDR）芯片平台技术	1	多核异构可重构 SDR SoC 架构设计技术	自主研发	多核异构可重构 SDR SoC 架构设计技术的先进性主要体现在基于异构多核可重构的系统结构、分级多层异构多核互联总线、多核协同与任务调度管理、多核负载均衡与功率控制技术以及多核任务数据存储与安全隔离等方面。公司的核心技术可灵活进行系统重构，并可灵活适应通信算法的优化和演进。该技术可实现不同制式通信设备的共平台设计，具备资源高度集约、能力协同倍增和应用模式灵活的特点。在相同空间或相同功耗下，可提供更高的计算能力，同时实现小尺寸和低功耗	已通过 9 项发明专利和 4 项集成电路布图设计专有权进行保护	批量应用阶段
	2	通用可重构 SDR 算法硬件处理器技术	自主研发	通用可重构 SDR 算法硬件处理器技术是基于公司自研的多体制通信算法，通过对不同体制通信算法抽象建模，提取各种公共算子，定义专用运算指令集和专用硬件处理器架构，高效实现特定算法的计算处理。该技术可以显著提升专用无线通信领域处理器能效比，具备可重构、可扩展和灵活性高的优点	已通过 1 项发明专利进行保护	批量应用阶段

技术 大类	序号	名称	技术 来源	技术先进性及具体表征	相关知识产权 保护措施	技术所处 阶段
	3	可重构通用射频接口控制技术	自主 研发	可重构通用射频接口控制技术的先进性主要体现在中频数据预处理通道、时序处理器、物理层定时器等。该技术通过射频接口控制器的灵活组合及重构，支撑宽带、窄带灵活切换及控制，并可产生多系统的帧定时，为软件系统提供“心跳”，实现多模通信的灵活转换及并发通信	已通过 1 项发明专利进行保护	批量应用阶段
	4	SDR 软件平台技术	自主 研发	①公司的 SDR 软件平台采用分层化设计，并在不同的处理器内核上部署了相同的 LMOS 实时操作系统，可在复杂异构多核 SoC 上既屏蔽不同 SoC 的差异，又屏蔽 SoC 内不同处理器内核结构的差异，为开发者提供统一的基础软件平台及高度一致性的实时操作系统服务。②SDR 软件平台采用全模块化设计，充分发挥了 SDR 技术的可重复配置特点，在相同的硬件平台上，为不同的通信制式波形提供了可按需灵活配置的组件，也可为新需求新增或改变功能模块，保证了 SDR 平台的可升级性与可扩展性。③标准化的编程接口使得通信制式波形在不同 SoC 或者 SoC 内不同处理器内核下都具备统一的开发接口，大大简化了软件编程的复杂度，使得通信制式波形具备很高的可移植性	已通过 4 项发明专利和 2 项软件著作权进行保护	批量应用阶段
	5	多波形管理技术	自主 研发	①公司的多波形管理技术是在 SDR 软件平台下，通过波形管理器在设备运行过程中进行动态的波形加载与卸载操作。该技术采用分层化结构隔离了 SDR 软件平台与通信波形，故而支持通信波形的独立加卸载而不影响软件平台，从而实现通信波形的快速切换。②多核异构 SoC 统一的架构和开发接口，可实现不同通信波形开发的一致性。③波形加载和运行资源的自适应分配和共享技术，可实现在单一 SoC 环境下对多个不相干波形并发的支持	商业秘密保护	批量应用阶段

3、研发水平

(1) 公司正在从事的研发项目情况

截至报告期末，公司预算金额投入 1,000 万元以上的主要在研项目及进展情况如下所示：

序号	项目名称	研发阶段	拟达到的研发目标及技术水平先进性
1	CX193X 解决方案产品开发项目	开发阶段	面向车联网市场、专网通信市场研发支持 5G、5G+C-V2X+北斗多模的通信芯片及解决方案，满足市场对通信芯片及解决方案的需求
2	高端窄带通信专用芯片项目	开发阶段	面向窄带专网通信市场研发低功耗、小体积、低成本的窄带通信套片，包括基带芯片和配套电源管理芯片、射频收发器芯片。通过芯片、协议乃至算法创新，可为行业专网带来以窄带授权频谱专网芯片与算法为核心的最优芯片方案，从而开拓关键语音国产化市场
3	车规级 C-V2X 芯片产品开发项目	开发阶段	研发车载前装市场的高性价比 C-V2X 车规级专用芯片，拥有 AEC-Q100 Grade2 能力，具备低成本的特点，并提供配套的电源管理芯片和射频芯片
4	SoC 芯片平台通用技术开发	开发阶段	开展大规模 SoC 芯片架构、通用模块设计、仿真验证，配套平台软件开发、测试等 SoC 芯片平台通用技术研发，建成涵盖设计工具、芯片 IP 等方面的开发平台以及芯片测试验证、可靠性保障等方面的试验平台
5	NTN 宽带终端基带芯片解决方案项目	开发阶段	研发 NTN 宽带终端芯片模组，能给终端客户提供高速率、体积小、功耗低、高安全的国产解决方案
6	卫星宽带终端产品化项目	开发阶段	面向卫星通信市场开发产品化的宽带终端解决方案，包括研发基础型和增强型卫星通信终端模块
7	卫星窄带波形解决方案项目	开发阶段	基于芯片平台，输出卫星窄带波形软件解决方案，满足应急等市场需求
8	CX1920 解决方案开发项目	开发阶段	面向车载前装 T-Box、车载后装 OBU、路侧设备 RSU 市场，研发基于 CX1920 芯片的解决方案
9	5G NTN 预研项目	开发阶段	研究 5G NR-V、5G NTN 的关键技术，为下一代通信芯片做技术储备。
10	自组网 3.0 平台项目	开发阶段	开发自组网 3.0 平台，提升吞吐率、时延、通信容量等关键指标能力，使自组网产品覆盖更多的潜在市场，更好满足市场需求
11	自组网 V2.1 开发项目	开发阶段	对自组网 V2 模块产品改进，以支持更远传输距离、更多收发特性等

(2) 研发投入情况

公司高度重视技术开发和创新工作，报告期内研发费用及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发费用	29,167.77	25,892.86	18,048.08

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	47,868.38	34,418.87	41,810.11
占营业收入的比例	60.93%	75.23%	43.17%

(3) 研发人员情况

研发人员对于芯片设计企业的产品迭代和公司发展有着至关重要的作用，截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 305 名，占员工总数的比例为 60.40%。

(三) 发行人主要经营和财务数据及指标

财务指标	2025-12-31/ 2025 年度	2024-12-31/ 2024 年度	2023-12-31/ 2023 年度
资产总计（万元）	271,295.67	290,275.19	276,462.63
股东权益合计（万元）	244,746.97	258,687.40	251,193.07
归属于母公司股东权益合计（万元）	239,594.51	253,538.45	246,075.38
每股净资产（元/股）	1.24	1.31	1.31
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	1.22	1.29	1.28
资产负债率（合并）（%）	9.79	10.88	9.14
资产负债率（母公司）（%）	17.20	17.73	15.78
营业收入（万元）	47,868.38	34,418.87	41,810.11
毛利率（%）	45.38	71.03	71.92
净利润（万元）	-14,189.23	-8,284.27	3,531.11
归属于母公司股东的净利润（万元）	-14,192.75	-8,315.51	3,449.69
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-18,879.10	-11,643.17	792.19
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	-18,833.55	-11,622.79	777.31
息税折旧摊销前利润（万元）	-876.45	3,730.19	11,975.19
加权平均净资产收益率（%）	-5.76	-3.42	1.47
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	-7.64	-4.78	0.33
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.04	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.04	0.02
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-16,241.29	-8,564.56	-24,677.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	-0.04	-0.13
研发投入占营业收入的比例（%）	60.93	75.23	43.17
利息保障倍数（倍）	-163.63	-64.99	50.98

财务指标	2025-12-31/ 2025 年度	2024-12-31/ 2024 年度	2023-12-31/ 2023 年度
应收账款周转率（次/年）	3.18	2.61	3.96
存货周转率（次/年）	1.13	0.50	0.82
流动比率（倍）	11.65	9.65	11.71
速动比率（倍）	10.63	8.78	10.98

注：上述主要财务指标计算方法如下：

- 1、每股净资产=期末股东权益合计/期末股本总数；
- 2、归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计/期末股本总数；
- 3、资产负债率=期末负债总额/期末资产总额；
- 4、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
- 5、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息费用+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+使用权资产折旧；
- 6、加权平均净资产收益率、基本每股收益及稀释每股收益均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行计算；
- 7、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率=扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润/加权平均净资产；
- 8、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；
- 9、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用；
- 10、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
- 11、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
- 12、流动比率=流动资产/流动负债；
- 13、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债。

（四）发行人存在的主要风险

1、存在累计未弥补亏损及持续亏损的风险

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为 3,449.69 万元、-8,315.51 万元和-14,192.75 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 777.31 万元、-11,622.79 万元和-18,833.55 万元。截至 2025 年末，公司累计未分配利润为-21,364.52 万元。公司存在累计未弥补亏损，主要是由于公司所处的无线通信 SoC 芯片领域具有技术壁垒高、研发周期长、研发投入大等特征，一方面前期需要大额的研发投入方能实现产业技术的商业化落地，另一方面还需持续保持大规模研发投入以推动产品迭代和技术升级。报告期内，公司研发投入分别为 18,048.08 万元、25,892.86 万元和 29,167.77 万元，占当期营业收入的比重分别达到 43.17%、75.23%和 60.93%，研发投入始终维持在较高水平。

作为无线通信 SoC 芯片设计企业，公司为确保相关产品持续保持行业竞争力，需要持续投入大量研发资金以保持技术优势，持续推出具有竞争力的产品。公司未来一定期间将持续存在大规模研发投入，若公司未来推出产品的市场竞争

力不及预期、核心技术产业化落地效果不佳，或下游市场需求出现大幅度下滑，公司的营业收入和营业利润可能无法达到预期，导致公司业绩下滑、未来一定期间内无法实现盈利，进而无法进行利润分配，将对股东的投资回报产生不利影响，同时，还有可能造成公司现金流紧张，对公司业务拓展、人才引进、团队稳定、持续研发投入、市场拓展等公司经营发展的各方面造成负面影响。

2、芯片定制服务业务收入存在较大波动的风险

报告期内，公司芯片定制服务业务实现收入分别为 10,635.63 万元、3,787.20 万元和 13,398.82 万元，占当期主营业务收入比例分别为 25.44%、11.01%和 28.00%。公司芯片定制服务业务系根据客户个性化需求，为其提供芯片设计服务，并可根据客户需求继续为其提供芯片量产服务。公司芯片定制服务业务与客户自身发展及其所处市场环境变化密切相关，因此报告期内该项业务收入存在一定波动，未来亦不排除公司芯片定制服务业务出现较大波动的风险。

3、供应商集中度高导致的供应链稳定风险

报告期内，公司向前五大供应商采购金额分别为 4,413.42 万元、12,894.31 万元和 16,931.64 万元，占当期采购总额的比例分别为 63.11%、78.34%和 82.48%，供应商集中度较高。公司采用 Fabless 模式经营，供应商主要为晶圆制造厂和封装测试厂，报告期内公司与主要供应商保持了稳定的合作关系。集成电路产业链中，晶圆制造厂和封装测试厂均属于重资产企业，行业市场集中度本身处于较高水平。

受主要供应商集中影响，若未来供应商出现产能不足、经营不善等情况或公司与供应商合作关系发生变化，公司需在短期内找到合适的替代供应商，否则将影响公司产品生产的稳定性和连续性。同时，若未来国际贸易摩擦进一步加剧，可能导致公司采购受到限制，进而影响销售订单正常履行，将会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

4、技术迭代风险

集成电路设计行业属于典型的“技术+资金”双重密集型行业，产品更新换代及技术迭代速度快，持续研发新产品、迭代新技术是公司在市场中保持竞争优势的重要手段。公司需要紧跟技术发展趋势和终端客户需求，通过持续加大研发投入推动技术创新，不断升级更新现有产品并研发新技术和新产品，从而保持技术先进性、提升产品核心竞争力。未来若公司未能及时、准确地把握客户市场需

求和技术发展趋势、或无法突破关键核心技术难关，无法研发出具有商业价值、契合客户市场需求的新产品，将对公司竞争能力和持续盈利能力产生不利影响。

5、国际贸易摩擦风险

近年来，国际政治经济形势日益复杂，部分国家、地区出于政治因素考虑，推行国际贸易保护主义，通过提高关税、限制进出口等方式加强贸易壁垒，使得国际贸易环境存在较多不稳定因素，我国面临的国际贸易环境不确定性和复杂性显著上升。集成电路产业链因全球化程度较高，成为受影响较为严重的领域之一。

鉴于集成电路行业的全球化分工及部分环节供应商集中度较高的行业特点，公司无法排除未来国际贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续加码、部分国家或地区出台对行业不利的限制政策等风险，从而可能会对公司的生产经营产生不利影响。

二、发行人本次发行情况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	人民币 1 元		
发行股数	不超过 403,029,995 股 （未考虑超额配售选择权的情况下）	占发行后总股本比例	不低于 10%且不超过 17%（未考虑超额配售选择权的情况下）
其中：发行新股数量	不超过 403,029,995 股 （未考虑超额配售选择权的情况下）	占发行后总股本比例	不低于 10%且不超过 17%（未考虑超额配售选择权的情况下）
股东公开发售股份数量	无	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过 2,370,764,681 股（未考虑超额配售选择权的情况下）		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍（每股收益按【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	【】元		
发行后每股净资产	【】元		
发行市净率	【】倍（按照每股价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	本次发行拟采用网下向投资者询价配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深交所认可的其他方式		
发行对象	本次发行对象为符合资格的询价对象和在深交所开设证券账户并具有创业板市场交易权限的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	余额包销		

募集资金总额	170,500.00 万元
募集资金净额	【】万元
募集资金投资项目	星地融合通信终端芯片及方案产品研发和产业化项目
	低空智联网芯片及产品研发和产业化项目
	研发中心能力建设项目
发行费用概算	本次发行费用总计【】万元，其中：保荐费用及承销费用【】万元，审计及验资费用【】万元，律师费用【】万元，用于本次发行的信息披露费用【】万元，发行手续费及材料制作费等其他费用【】万元（以上费用均不含对应的增值税）
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况（如有）	若公司决定实施高管及员工战略配售，则在本次发行股票注册后、发行前，履行内部程序审议该事项的具体方案，并依法进行披露
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况（如有）	保荐人将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照深交所相关规定执行；保荐人及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向深交所提交相关文件

（二）本次发行上市的重要日期

刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式

（一）本次证券发行上市的保荐代表人

中信建投证券指定潘可、李志强担任本次宸芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

潘可先生：保荐代表人、硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁。曾主持或参与的项目有：长久物流、济民制药、国检集团等首次公开发行股票并上市项目；中国银河、长久物流等公开发行可转债；天华新能、继峰股份等向特定对象发行股票项目；中持股份、西王食品等非公开发行股票项目；宸芯科技新三板挂牌及定增、*ST 建工重大资产置换及发行股份购买资产独立财务顾问、新宁物流发行股份购买资产并募集配套资金独立财务顾问、京能电力公开发行公司债券、碧桂园面向合格投资者发行公司债券等。作为保荐代

表人,目前无其他负责尽职推荐的在审项目,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

李志强先生:保荐代表人、硕士研究生,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁。曾主持或参与的项目有:成都银行、渝农商行、百华悦邦等首次公开发行股票并上市项目;居然之家、大唐发电、九鼎新材、福田汽车、大通燃气、天华院等非公开发行股票项目;中国重工、中国中铁等重大资产重组项目;工商银行、中信银行等优先股项目;成都银行可转债项目;福田汽车、新奥中国投公司债项目。作为保荐代表人,目前无其他负责尽职推荐的在审项目,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

(二) 本次证券发行上市项目协办人

本次证券发行项目的协办人为杨坚,其保荐业务执行情况如下:

杨坚先生:硕士研究生,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁。曾主持或参与的主要项目有:派瑞特气、天玛智控等首次公开发行股票项目;安井食品、邮储银行、建设银行等向特定对象发行股票项目;新奥股份发行股份购买资产、辽宁能源上市公司收购等财务顾问类项目;富滇银行增资扩股、农业银行永续债、农业银行二级资本债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

(三) 本次证券发行上市项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括王河琪、张廷、刘书翔、林东权、米维卿、刘展、曾诚、魏鹏程、张铁、钱堃、魏晓辉、苏明、李晟然、周百川。

王河琪先生:硕士研究生,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理,曾主持或参与的项目有:昂瑞微 IPO 等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

张廷先生:硕士研究生,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理,曾参与或执行的项目主要有:天玛智控 IPO、英发睿能 H 股 IPO、成都银行可转债、中国银行定增、邮储银行定增、建设银行定增、爱旭股份定增、邮储银行非公开、中国船舶换股吸并中国重工、新奥股份重大资产重组等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

刘书翔先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：软通动力 IPO、爱迪特 IPO、华谊兄弟向特定对象发行股票等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

林东权先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾参与的项目主要有：长源电力非公开、建设银行 2025 年定向增发、邮储银行 2025 年定向增发等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

米维卿先生：保荐代表人、硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁。曾主持或参与的项目有：中科软 A 股 IPO 项目、海看股份创业板 IPO 项目、山东路桥发行股份购买资产并募集配套资金项目、洲明科技公开发行可转债项目、英发睿能 H 股 IPO。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

刘展先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁。曾主持或参与的项目有：中国银河 A 股 IPO、威力传动 IPO、华夏银行 2018 年非公开发行、华夏银行 2022 年非公开发行、农业银行非公开发行、中国银河可转债、北京银行小微金融债、康泰生物非公开、渤海汽车重大资产购买、宸芯科技新三板挂牌及定增、动力未来新三板挂牌、动力未来定增等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

曾诚先生：保荐代表人、硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：金龙鱼、中科星图、宁德时代、天玛智控等首次公开发行股票项目，星图测控股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市项目；大唐电力、闽东电力、山东药玻、华纺股份等非公开发行股票项目；中科星图、当升科技等向特定对象发行股票项目；当升科技发行股份购买资产、创世纪发行股份购买资产并募集配套资金等财务顾问项目；宁德时代、京能电力等面向合格投资者公开发行公司债项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

魏鹏程先生：博士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目主要有：天玛智控 IPO 项目；星图测控北交所 IPO 项目；

邮储银行定向增发、龙蟠科技定向增发等再融资项目；中国船舶吸收合并中国重工、株洲高科收购旷达科技等财务顾问项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张铁先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：仙琚制药 IPO、光线传媒 IPO、拉卡拉 IPO、澜起科技 IPO、中芯国际 IPO、申菱环境 IPO、炬光科技 IPO、思特威 IPO、爱迪特 IPO、景兴纸业非公开发行、华录百纳非公开发行、慈文传媒非公开发行、中国长城非公开发行、南大光电向特定对象发行股票、申菱环境向特定对象发行股票、软通动力向特定对象发行股票、航天信息可转债、常熟汽饰可转债、艾为电子可转债、三湘股份重大资产重组等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

钱堃先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：昂瑞微 IPO 等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

魏晓辉先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁。曾主持或参与的项目有：北京银行 2017 年非公开发行股票、华夏银行 2018 年非公开发行股票、北京银行 2019 年非公开发行优先股、康泰生物 2021 年可转债、华夏银行 2022 年非公开发行股票、金正大发行股份购买资产财务顾问项目、宸芯科技新三板挂牌及定增、北京银行 2021 年无固定期限资本债券、北京银行 2020-2021 年小微金融债、中泰证券公开发行公司债券、中泰证券非公开发行公司债券、中泰证券非公开发行次级债券、中国银河非公开发行公司债券。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

苏明先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务委员会高级经理，曾参与的项目主要有：宸芯科技新三板挂牌及定增项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李晟然先生：保荐代表人、硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁。曾主持或参与的项目有：开源证券首次公开发行 A 股股票、国人科技首次公开发行 A 股股票、五方光电首次公开发行 A 股股票、中孚信息首次公开发行 A 股股票、中孚信息非公开发行股票、中孚信息重大资产重组、

九江银行非公开发行股票等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

周百川先生：保荐代表人、硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监。曾主持或参与的主要项目有：富祥股份、艾艾精工、天玛智控等IPO项目；长源电力、长安汽车、居然之家、捷佳伟创、北汽蓝谷、华银电力等非公开发行股票项目；爱旭股份定增；中信银行、璞泰来等可转债项目；中信银行、建设银行等优先股项目；天音控股、北汽蓝谷、居然之家、首钢股份、龙源电力等重大资产重组项目；金融街控股豁免要约收购等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（四）联系地址、电话和其他通讯方式

保荐人（主承销商）：	中信建投证券股份有限公司
联系地址：	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼
邮编：	100026
联系电话：	010-56052549

四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

（一）由于发行人控股股东中国信科的部分下属公司为上市公司，因此除可能存在的少量、正常二级市场证券投资外，保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在直接或间接持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项

保荐人已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审

慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及深交所有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会、深交所规定的其他事项。

中信建投证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、深交所对推荐证券上市的规定，自愿接受深交所的自律监管。

六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明

2026年5月11日及2026年5月27日，发行人分别召开第二届董事会第四次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》等关于首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案。

经核查，本保荐人认为，发行人已就本次首次公开发行股票并在创业板上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深交所规定的决策程序。

七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程

（一）本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”，行业代码为“I6520”；根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，公司所属行业为“1 新一代信息技术产业”之“1.3 电子核心产业”之“1.3.1 集成电路”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为新兴软件和新型信息技术服务中的新型信息技术服务，属于新一代信息技术产业；根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司主营业务属于鼓励类的第二十八大类“信息产业”中的第 4 小类“集成电路”。

公司专注于无线通信 SoC 芯片及模组类产品的研发、设计及销售，主营业务不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条规定的行业，亦不属于产能过剩行业、《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业。

公司符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第四条第二套标准相关指标要求，具体情况如下：

创业板定位相关指标	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元	是	公司最近三年累计研发投入 73,108.72 万元
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%	不适用	2025 年度,公司实现营业收入为 4.79 亿元,超过 3 亿元。不适用营业收入复合增长率要求。

注：最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已在境外上市的红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。

（二）保荐人的核查程序和核查结论

保荐人主要履行了如下核查程序：

- （1）查阅国家相关行业政策及法律法规、发行人所处行业的研究报告以及同行业可比公司资料，了解发行人所属行业是否属于国家产业政策支持范畴；
- （2）取得并查阅发行人核心技术列表及清单、获取发行人发明专利明细，

了解其权利归属、有效期限、有无权利受限或诉讼纠纷等情况；访谈主要研发人员，对相关专利在主要产品中的应用情况进行了核查；

（3）访谈发行人相关负责人，了解技术创新的具体内容以及在行业内的先进性；

（4）访谈下游主要客户，了解发行人的市场地位等。

经核查，保荐人认为，发行人符合创业板板块定位及国家产业政策。

八、保荐人关于发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明

本次证券发行符合相关法律法规规定的上市条件，具体情况如下：

（一）本次发行符合《证券法》规定的相关条件

中信建投证券对发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市是否符合《证券法》规定的发行条件进行了逐项核查，核查结果如下：

1、发行人具备健全且运行良好的组织机构

发行人依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东会、董事会和管理层组成的发行人治理架构，在董事会下设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并建立了独立董事工作制度和董事会秘书制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为发行人高效、稳健经营提供了组织保证。发行人股东会、董事会及管理层均根据《公司法》《公司章程》行使职权和履行义务，具备健全且运行良好的组织机构。

综上所述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

2、发行人具有持续经营能力

发行人系依法设立并有效存续的股份有限公司，生产经营符合国家产业政策，发行人的营业期限为长期，不存在因违法经营而被相关行政管理部门责令停业整顿或吊销营业执照的情形，不存在根据法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形。

发行人主要专注于无线通信 SoC 芯片及模组类产品的研发、生产及销售，主要为客户提供芯片产品、模组类产品、芯片定制服务及相关技术服务。报告期内，发行人营业收入分别为 41,810.11 万元、34,418.87 万元和 47,868.38 万元。

报告期各期末，发行人资产总额分别为 276,462.63 万元、290,275.19 万元和 271,295.67 万元，发行人资产规模相对稳定。发行人资产质量良好，运营管理能力较强，具有持续经营能力。

综上所述，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3、最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

发行人聘请的致同会计师依据中国注册会计师审计准则对发行人报告期内财务报告进行了审计，并出具了“致同审字（2026）第 110A025667 号”标准无保留意见审计报告，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告。

综上所述，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

4、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

发行人控股股东为中国信科，实际控制人为国务院国资委。发行人及控股股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

5、经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件

发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件，符合《证券法》第十二条第一款第（五）项的规定。

综上所述，发行人本次发行符合《证券法》规定的发行条件。

（二）本次发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的相关条件

本保荐人对发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市是否符合《注册管理办法》规定的发行条件进行了逐项核查。经核查，保荐人认为，发行人本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件，具体情况如下：

1、主体资格情况

宸芯有限成立于 2019 年 12 月 20 日，于 2022 年 11 月 24 日按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，依法成立且持续经营时间三年以上。公司已依法设立股东会、董事会以及开展日常经营业务所需的其他必要内部机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第

十条的有关规定。

2、发行人财务规范情况

发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由致同会计师事务所的注册会计师出具了“致同审字（2026）第 110A025667 号”标准无保留意见审计报告，符合《注册管理办法》第十一条第一款的规定。

3、发行人内部控制情况

发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的《内部控制审计报告》（致同审字（2026）第 110A026035 号），符合《注册管理办法》第十一条第二款的规定。

4、发行人资产完整性及业务、人员、财务、机构独立情况

发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

5、发行人业务、控制权及主要人员的稳定性

发行人主营业务、控制权、管理团队稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东支配的股东所持公司的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

6、发行人资产权属情况

发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷、重大偿债风险、重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

7、发行人合法合规情况

发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

8、发行人、控股股东及实际控制人的守法情况

发行人实际控制人为国务院国资委。最近三年内，发行人及控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

9、董事、审计委员会和高级管理人员的守法情况

发行人的董事、高级管理人员最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定。

综上所述，发行人本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件。

（三）本次发行符合《上市规则》规定的相关条件

发行人本次发行符合《上市规则》规定的上市条件，具体情况如下：

1、符合中国证监会规定的创业板发行条件

发行人符合中国证监会《注册管理办法》规定的发行条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一项的规定。

2、发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元

本次发行前，发行人股份总数为 196,773.4686 万股，本次拟发行股票数量不超过 40,302.9995 万股。因此，本次发行后公司股本总额预计不低于 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第二项的规定。

3、公开发行的股份达到公司股份总数的 10%以上

本次发行前，公司股份总数为 196,773.4686 万股，公司股本总额超过 4 亿元。本次拟发行股票数量不超过 40,302.9995 万股，预计发行股票数量占发行后总股本比例不低于 10%，符合《上市规则》第 2.1.1 条第三项的规定。

4、市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准

公司选择的上市标准为《上市规则》2.1.2 条之“（四）预计市值不低于 30 亿元，最近一年营业收入不低于 2 亿元，最近三年营业收入复合增长率不低于 30%；或者预计市值不低于 40 亿元，最近一年营业收入不低于 2 亿元，最近三年累计研发投入不低于 1 亿元且占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%”。

公司最近一次股权融资对应的投后估值为 68.87 亿元，公司预计市值不低于 40 亿元。根据致同会计师出具的致同审字（2026）第 110A025667 号标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度营业收入为 47,868.38 万元，最近三年累计研发投入 73,108.72 万元，占最近三年累计营业收入的比例为 58.91%。

综上，公司符合上市标准四中的第二项指标要求。

5、公司符合深圳证券交易所要求的其他上市条件

公司符合深圳证券交易所要求的其他上市条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第五项的规定。

经逐项核查，本保荐人认为，发行人符合《证券法》《注册管理办法》及《上市规则》规定的公开发行股票并在创业板上市的条件。

九、持续督导期间的工作安排

事项	安排
（一）持续督导事项	在本次发行结束当年的剩余时间以及以后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，确保保荐人对发行人关联交易事项的知情权，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止董事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人有效执行并进一步完善《公司章程》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露义务；督导发行人及时向保荐人通报将进行的重大关联交易情况，并按照公平、独立的原则对关联交易发表意见。
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定，适时审阅发行人信息披露文件。
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人执行已制定的《对外担保制度》等制度，规范对外担保行为；持续关注发行人为他人提供担保等事项；如发行人拟为他人提供担保，保荐人要求发行人通知或咨询保荐人，并督导其履行相关信息披露义务。
（二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	按照保荐制度有关规定积极行使保荐职责；严格履行保荐协议、建立通畅的沟通联系渠道。
（三）发行人和其他中介机构配合	发行人协调相关当事人配合保荐人的保荐工作，并督促

事项	安排
保荐人履行保荐职责的相关约定	其聘请的其他证券服务机构协助保荐人做好保荐工作。
（四）其他安排	无

十、保荐人认为应当说明的其他事项

无其他需要说明的事项。

十一、保荐人关于本项目的推荐结论

本次发行上市申请符合法律法规和中国证监会及深交所的相关规定。保荐人已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐人认为：本次宸芯科技股份有限公司发行上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深交所有关规定；中信建投证券同意作为宸芯科技股份有限公司本次创业板发行上市的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宸芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

项目协办人签名： 杨坚

杨 坚

保荐代表人签名： 潘可

潘 可

李志强

李志强

内核负责人签名： 徐子桐

徐子桐

保荐业务负责人签名： 刘乃生

刘乃生

法定代表人/董事长签名： 刘成

刘 成

